股票代码:601231 股票简称:环旭电子 公告编号:2021-033

环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd.

股票简称:环旭电子

股票代码:601231

注册地址:上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558 号

保荐机构(联席主承销商) 海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

二〇二一年三月

第一节 重要声明与提示

环旭电子股份有限公司(以下简称"环旭电子"、"发行人"、"公司"或"本公司")全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所(以下简称"上交所")、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2021 年 3 月 2 日刊载于《证券时报》的《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")全文。

本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券名称(全称):环旭电子股份有限公司可转换公司债券

二、可转换公司债券简称:环旭转债

三、发债种类:实名制记账式

四、可转换公司债券代码:113045

五、可转换公司债券发行量:345,000.00 万元(3,450.00 万张)

六、可转换公司债券上市量:345,000.00 万元(3,450.00 万张)

七、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

八、可转换公司债券上市时间:2021 年 4 月 2 日

九、可转换公司债券存续的起止日期:2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3 月 3 日

十、可转换公司债券转股期的起止日期:2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日

十一、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十二、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限公司上海分公司

十三、托管方式:账户托管

十四、登记公司托管量:345,000.00 万元

十五、保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司

十六、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债未提供担保。

十七、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券经中诚信评级,根据中诚信出具的 CCXI-20203844D-02 号《公开发行可转换公司债券信用评级报告》,发行人主体长期信用等级为 AA+,本次可转换公司债券信用等级为 AA+,评级展望为稳定。公司本次发行的可转债上市后,中诚信国际信用评级有限公司将进行跟踪评级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]167 号"文核准,公司于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 345,000.00 万元。本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,本次发行认购金额不足 345,000.00 万元的部分由联席主承销商包销。包销基数为 345,000.00 万元,联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 103,500.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

经上交所自律监管决定书 [2021]133 号文同意,公司 345,000.00 万元可转换公司债券将于 2021 年 4 月 2 日起在上交所挂牌交易,债券简称"环旭转债",债券代码"113045"。该可转换公司债券上市后不可进行质押式回购。

本公司已于 2021 年 3 月 2 日在《证券时报》刊载了《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《环旭电子股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

中文名称:环旭电子股份有限公司

英文名称:Universal Scientific Industrial(Shanghai)Co., Ltd.

股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:环旭电子

股票代码:601231

注册资本:人民币 220,960.9072 万元

法定代表人:陈昌益

董事会秘书:史金鹏

公司住所:上海市张江高科技园区集成电路产业区张东路 1558 号

邮政编码:201203

联系电话:86-21-58968418

传真:86-21-58968415

经营范围:提供电子产品设计制造服务(DMS),设计、生产、加工新型电子元器件、计算机高性能主机板、无线网络通信元器件、移动通信产品及模块、零配件,维修以上产品,销售自产产品,并提供相关的技术咨询服务;电子产品、通讯产品及相关零配件的批发和进出口,并提供相关配套服务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

二、发行人历史沿革

(一)发行人设立及上市

1、2003 年 1 月,公司设立

环旭电子前身为环旭电子(上海)有限公司(以下简称"环旭有限"),由 Real Tech Holding Limited(以下简称"RTH 公司")持有 100%股权,于 2003 年 1 月 2 日在上海市工商局浦东分局注册成立,并领取了《企业法人营业执照》(注册号:企独沪浦总字第 316475 号(浦东)),其注册资本为 2,800 万美元,投资总额为 7,000 万美元。环旭有限就其成立事宜已取得上海市外国投资工作委员会于 2002 年 11 月 20 日出具的沪外资委批字(2002)第 1656 号《关于设立环旭电子(上海)有限公司的批复》同意。2002 年 12 月 5 日,上海市外国投资工作委员会向环旭有限核发外经贸沪独资字(2002)3936 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2、2006 年 3 月,第一次增资

2005 年 12 月 28 日,环旭有限董事会作出决议,同意环旭有限注册资本增至 4,800 万美元,投资总额增至 13,000 万美元。

就本次增资事宜,环旭有限于 2006 年 3 月 8 日取得上海市外国投资工作委员会出具沪外资委协[2006]611 号《关于环旭电子(上海)有限公司增资的批复》同意,并于 2006 年 3 月 14 日获换发商外资沪独资字[2002]3936 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2006 年 3 月 16 日,环旭有限就本次增资事宜在上海市工商局浦东分局完成变更登记手续,并获换发《企业法人营业执照》(注册号:企独沪浦总字第 316475 号(浦东))。

3、2006 年 9 月,第二次增资

2006 年 7 月 10 日,环旭有限董事会作出决议,同意环旭有限注册资本增至 5,100 万美元,投资总额增至 13,600 万美元。

环旭有限本次增资事宜,已于 2006 年 8 月 18 日获上海市外国投资工作委员会出具沪外资委协[2006]3261 号《关于环旭电子(上海)有限公司增资的批复》同意,并于 2006 年 8 月 30 日获换发商外资沪独资字[2002]3936 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

2006 年 9 月 13 日,环旭有限就本次增资事宜在上海市工商局浦东分局完成变更登记手续,并获换发《企业法人营业执照》(注册号:企独沪浦总字第 316475 号(浦东))。

4、2007 年 12 月,第一次股权转让

2007 年 12 月 10 日,RTH 公司与环诚科技签订《股权转让协议》,RTH 公司将其持有的环旭有限的 100%股权按原投资成本作价以 5,100 万美元的价格转让给环诚科技。同日,环旭有限董事会作出决议,同意本次股权转让事宜。

就本次股权转让事宜,环旭有限获得上海市外国投资工作委员会于 2007 年 12 月 18 日出具的沪外资委协[2007]5424 号《关于同意环旭电子(上海)有限公司股权转让的批复》批准,并于 2007 年 12 月 21 日获换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2007 年 12 月 28 日,环旭有限就本次股权转让事宜在上海市工商局浦东分局完成变更登记手续,并获换发《企业法人营业执照》(注册号:310115400112763)。

5、2008 年 3 月,第二次股权转让

2008 年 1 月 15 日,环诚科技与环胜电子(深圳)有限公司(以下简称"环胜深圳")、日月光半导体(上海)有限公司(以下简称"日月光半导体")签订《股权转让协议》,环诚科技将其持有的环旭有限的 1%股权转让给环胜深圳和日月光半导体;其中,环胜深圳及日月光半导体各受让 0.5%股权,股权转让价格分别为 852,916 美元。同日,环旭有限独资股东环诚科技作出书面决议,同意本次股权转让事宜。

就本次股权转让事宜,环旭有限获得上海市外国投资工作委员会于 2008 年 3 月 3 日出具的沪外资委协[2008]672 号《关于同意环旭电子(上海)有限公司股权转让的批复》批准,并于 2008 年 3 月 6 日获换发商外资沪合资字[2002]3936 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2008 年 3 月 21 日,环旭有限就本次股权转让事宜在上海市工商局浦东分局完成变更登记手续,并获换发《企业法人营业执照》(注册号:310115400112763)。

6、2008 年 6 月,整体变更为股份有限公司

2008 年 3 月 12 日,环诚科技、日月光半导体及环胜深圳作为发起人签署了《环旭电子股份有限公司发起人协议书》,约定股份有限公司成立时发行股份总数为 416,056,920 股,每股面值人民币 1 元,股份有限公司注册资本为 416,056,920 元;股份有限公司发行的全部股份以环旭有限截至 2007 年 9 月 30 日经审计账面净资产值按约 1:0.5495 的比例折算,由各方按照各自在有限责任公司的持股比例足额认购。同日,环旭有限董事会作出决议,同意环旭有限整体变更为股份有限公司的相关事宜。2008 年 6 月 19 日,环旭有限召开创立大会,审议通过了环旭有限整体变更为股份有限公司的相关议案。

就整体变更为股份有限公司事宜,环旭电子已获得商务部于 2008 年 6 月 11 日核发的商资批[2008]654 号《商务部关于同意环旭电子(上海)有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》及商务部于 2008 年 6 月 24 日核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资资审 A 字[2008]0123 号)批准。

2008 年 6 月 30 日,环旭有限在上海市工商局完成整体变更为股份有限公司的工商变更登记,并获换发《企业法人营业执照》(注册号:310115400112763)。

7、2010 年 8 月,增加注册资本

2009 年 9 月 30 日,环旭电子召开 2009 年度第一次临时股东大会,审议通过了《利润分配和资本公积金转增股本方案》,同意环旭电子注册资本由 416,056,920 元增至 904,923,801 元,本次新增注册资本由环旭电子以未分配利润 210,524,801.52 元及资本公积 278,342,079.48 元转增。

环旭电子就本次增资已取得上海市商务委员会 2010 年 1 月 4 日出具的沪商外资批 [2010]8 号《市商务委关于同意环旭电子股份有限公司增资的批复》批准,并取得换发的商外资沪股份字[2002]3936 号《中华人民共和国港澳台侨投资企业批准证书》。

2010 年 3 月 31 日,环旭电子就本次增资事宜在上海市工商局完成工商变更登记手续,并获换发《企业法人营业执照》(注册号:310115400112763)。

8、2010 年 12 月,第三次股权转让

2010 年 12 月 6 日,环旭电子股东环胜深圳与日月光半导体签订了《股权转让协议》,环胜深圳将其所拥有的环旭电子 0.5%股份全部转让予日月光半导体,转让价格以环旭电子 2010 年 3 月 31 日经审计净资产为依据,最终确定的价款为 705 万元。2010 年 12 月 5 日,日月光半导体召开临时股东大会,同意本次股权转让事宜。股权转让后,日月光半导体持有环旭电子 1%的股份。

环旭电子就本次股权转让事宜,已取得上海市商务委员会于 2010 年 12 月 29 日出具的"沪商外资批[2010]3639 号"《市商务委关于同意环旭电子股份有限公司股权转让的批复》批准,并于 2011 年 1 月 10 日取得上海市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

9、2012 年 2 月,首次公开发行股票并上市

经中国证监会证监许可[2012]74 号《关于核准环旭电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,环旭电子于 2012 年 2 月 10 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)10,680 万股。本次发行后环旭电子总股本由 904,923,801 股变更为 1,011,723,801 股。

就首次公开发行股票上市事宜,环旭电子已取得上海市商务委员会于 2012 年 3 月 31 日出具的沪商外资批[2012]903 号《商务委关于同意环旭电子股份有限公司增资扩股的批复》。

2012 年 5 月 9 日,环旭电子就首次公开发行股票并上市事宜在上海市工商局办理完成工商变更登记手续,并获换发《企业法人营业执照》(注册号:310115400112763)。

(二)发行人上市后股本变化情况

1、2014 年 11 月,非公开发行股票

经中国证监会《关于核准环旭电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1102 号文)核准,公司以人民币 27.06 元每股的发行价格非公开发行 76,237,989 股股票,并于 2014 年 11 月 18 日在证券登记结算公司办理完毕登记,发行完成后公司总股本为 1,087,961,790 股,本次发行净募集资金 201,768.96 万元。

就本次非公开发行股票事宜,环旭电子已取得了上海市商务委员会于 2015 年 2 月 26 日出具的沪商外资批[2015]736 号《市商务委关于同意环旭电子股份有限公司增资的批复》,并取得上海市人民政府于 2015 年 3 月 2 日换发的商外资沪股份字[2012]3936 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2015 年 3 月 24 日,环旭电子就本次非公开发行股票事宜在上海市工商局完成工商变更登记手续,并获换发《企业法人营业执照》(注册号:310115400112763)。

2、2015 年 4 月,资本公积转增股本

2015 年 4 月 24 日,环旭电子召开 2014 年度股东大会并决议通过《2014 年度利润分配方案》,公司以总股本 1,087,961,790 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.94 元(含税)及资本公积金每 10 股转增 10 股,分配完成后公司总股本变为 2,175,923,580 股。

就本次资本公积转增股本事宜,环旭电子已取得中国(上海)自由贸易区管理委员会于 2015 年 11 月 27 日出具的备案号 NO.ZJ201500159《中国(上海)自由贸易试验区外商投资企业备案证明》。

2015 年 12 月 15 日,环旭电子就本次资本公积转增股本事宜在上海市工商局完成工商变更登记手续,并获换发《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91310000745611834X)。

3、2015 年股票期权激励计划

2015 年 11 月 17 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<环旭电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关股权激励计划(以下简称"2015 股权激励计划")的议案。根据公司的说明,2015 股权激励计划的部分激励对象已经通过公司定向增发股份的方式行权,截至 2020 年 6 月 30 日,公司实际总股本已经增至 2,181,283,330 股。公司拟后续完成相关工商等主管机关的变更登记手续。

4、2019 年股票期权激励计划

2019 年 11 月 18 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关股权激励计划(以下简称"2019 股权激励计划")的议案。截止 2020 年 6 月 30 日,该次股权激励计划尚处于等待期,不存在行权的情况。

三、发行人主要经营情况

(一)发行人的经营范围及主营业务

发行人营业执照载明的经营范围为:提供电子产品设计制造服务(DMS),设计、生产、加工新型电子元器件、计算机高性能主机板、无线网络通信元器件,移动通信产品及模块、零配件,维修以上产品,销售自产产品,并提供相关的技术咨询服务;电子产品、通讯产品及相关零配件的批发和进出口,并提供相关配套服务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

发行人主营业务为国内外的品牌厂商提供通讯类、消费电子类、电脑及存储类、工业类、汽车电子类和其他类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务。

(二)发行人主要产品及服务

公司是全球 D(MS)2 领导厂商,通过为品牌客户提供更有附加值的设计制造及相关服务,更多参与到整个产业链的应用型解决方案,提升产品制造及整体服务的附加值。公司未来将围绕为客户创造价值的核心理念,拓展优质客户并与客户建立更加紧密的合作关系,在所服务产品领域从制造服务商逐步发展成为系统方案解决商及综合服务商。公司主要产品包括通讯产品、消费电子产品、电脑主板和存储产品、工业电子产品、汽车电子产品系列。

(三)公司的竞争优势

1、技术优势

公司是多个业务细分领域的领导厂商,是 SiP 微小化技术的行业领导者,行业地位突出。公司为穿戴及通讯产品提供微小化技术外,同时也为存储、工业及车用电子产品提供电子封装制程、高密度 SMT 制程等多元制程服务,在新产品量化生产方面具有丰富的经验。

公司多年来致力于高密度 SMT 制程开发,目前领先业界完成缩小零件间距 50μm 及超微小型被动组件 SMT 制程的开发。高密度 SMT 制程可协助客户在不使用特殊封装技术及昂贵基材的条件下,将 PCB 微小化、提高零件密度、增加产品效能及单位产出、降低成本、进而提高产品竞争力。公司在"EMS+"增值服务以价值分析和价值工程能力从制造端的角度在量产前协助客户重新检视产品设计,包括电路设计、物料选择、生产流程的优化建议。公司"EMS+"增值服务能帮客户在不影响产品质量的情况下降低生产与设计成本。

2、产品优势

公司拥有电子产品专业设计制造(涵盖电子零组件、零配件和整机)及系统组装的综合实力,还具备战略性精选细分领域和整合产品的优势。公司的产品组合"丰富而平衡",涵盖 3C(通讯、消费、电脑)产品、工业类和汽车电子,在"精中选优"的基础上通过实施跨细分领域、跨行业的横向整合,顺应电子产业不断融合的发展趋势,力争在不同阶段均能够把握住市场机遇,动态实现公司产品的最优化组合,推动公司持续稳定发展。

3、客户优势

公司已经与众多国际一流的大型电子产品品牌商建立了长期稳定的供应链合作关系,并在其核心产品的供应链中都占有重要位置。基于与国际一流电子品牌厂商的紧密合作,对电子产品市场和电子信息技术主流发展趋势的密切跟进,公司能够对市场需求变化快速作出反应,及时进行前瞻性部署和新产品的超前研发,同时公司将通过强化核心零组件产品及整机产品的纵向垂直整合,凸显服务价值,增强客户粘性,拓展优质客户,进而巩固和提升公司在供应链中综合服务商的战略地位。

4、管理优势

公司管理团队较为稳定,主要管理人员平均拥有超过 28 年的电子制造业规模化生产管理经历,具有较强的凝聚力和企业管理能力,并在长期管理实践中形成了富有特色、行业领先且行之有效的人才管理、生产经营管理和内部控制体系。通过合格供应商管理、建立 Vendor Managed Inventory(供应商管理的库存,以下简称"VMI")管理体系和制定库存物料管理的制度及标准作业流程等,完善自身的供应链管理系统,公司能够依据客户需求及时、高效地采购各种原材料,完成所有产成品的装配及相关的售后服务,对市场变化作出快速响应,并通过各个供应流程的优化,缩短交货周期,提高生产效率。

此外,公司在智能制造方面亦处于业内领先地位,通过引进 SAP 系统、MES 系统等多个信息化系统,针对生产预算、计划、物料、仓储、成本费用等各个方面进行精细化管理。其中,ERP 系统通过财务、成本控制、物料管理、生产计划管理、销售等系统模块将相应的作业流程整合于同一系统中,提升公司的生产管理及运营效率;MES 系统可实现大量订单精确排产的智能化,并针对每个订单产品生产的全流程制定了完善的作业指导书,确保在频繁切换生产线时产品生产的高效率、高良率;并通过系统报表实时呈现生产现场的生产进度、目标达成状况、产品品质状况,以及生产的人、机、料的利用状况;还可实时监控产品生产质量,实现产品生产的有效管理及可追溯性;WMS 系统可集成获取库房内部管理信息作为出、入库等操作的指令,并将所有操作结果实时的反馈到 ERP 系统,通过两套系统的有效实时互动,实现库存的更加透明化和合理化,优化了库存进出及储位管理。

5、成本优势

公司经过多年的经营积累,在成本控制方面形成了明显的优势:首先,公司在产品开发环节通过合理规划和材料的合理选择,使产品具备成本优势;其次,公司拥有全球采购的资源和经验,有条件在全球范围内进行合理的采购选择;公司已经形成了完善的产品供应商评选和管理体系,而且由于集中采购,订单量大,采购规模效益明显,具有较强的议价能力;第三,凭借先进的管理经验、实时全面的生产监控和高效的物料管理体系,通过对产线的合理布局,对生产管理的制度化、系统化和标准化,对产线员工的严格培训与管理,实现高效的生产率,有效控制产品单位生产成本。

6、全球化布局优势

公司目前在中国大陆、台湾地区、墨西哥、波兰、韩国有多个生产据点,服务全球知名品牌厂商。为适应"全球化需求、在地化服务"的市场趋势,公司从 2018 年开始加快全球化扩张,在海外生产据点投资扩产,此外,启动多项策略投资,与中科曙光在昆山成立合资公司、投资 PHI Fund 汽车电子基金、参与新加坡上市公司万德国际(Memtech)私有化、收购欧洲第二大 EMS 公司法国 Financière AFG S.A.S. 全部股权、在越南海防拟投资建设新厂。公司将成为更加国际化运营的公司,着眼全球市场,整合全球资源。

四、发行前股本结构及前十名股东持股情况

(一)本次发行前发行人股本结构

截至 2020 年 6 月 30 日,公司总股本为 2,181,283,330 股,股本结构如下:

序号	股份类型	数量(股)	比例
1	有限售条件股份	0	0
2	无限售条件股份	2,181,283,330	100.00
3	股份总数	2,181,283,330	100.00

(二)发行人前十大股东持股情况

截至 2020 年 6 月 30 日,公司前十名股东持股情况如下:

单位:股

序号	股东名称	股东性质	持股比例	持股数	限售股份数量
1	环诚科技有限公司	境外法人	77.19%	1,683,749,126	-
2	香港中央结算有限公司	未知	3.29%	71,838,116	-
3	中国证券金融股份有限公司	未知	1.68%	36,750,069	-
4	日月光半导体(上海)有限公司	境内非国有法人	0.83%	18,098,476	-
5	中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.64%	14,050,850	-
6	环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.60%	13,037,477	-
7	中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.58%	12,736,500	-
8	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	未知	0.23%	5,110,405	-
9	全国社保基金四零一组合	未知	0.22%	4,799,864	-
10	交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	未知	0.22%	4,782,479	-
合计			85.48%	1,864,953,362	

第五节 发行与承销

一、本次发行情况

(一)发行数量:本次发行可转债总额为人民币 345,000.00 万元(3,450.00 万张)

(二)向原股东发行的数量和配售比例:

最终向持有公司有限售条件股份的外资股东优先配售的环旭转债总计为 31,253 手,即 31,253,000 元,占本次发行总量的 0.91%。根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向除持有公司有限售条件股份的外资股东外,公司其他原 A 股股东(含限售股股东)优先配售的环旭转债总计为 2,897,397 手,即 2,897,397,000 元,占本次发行总量的 83.98%;网上投资者最终缴款认购 508,639 手,占本次发行总量的 14.74%;网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,包销数量为 12,711 手,占本次发行总量的 0.37%。

(三)发行价格:按票面金额平价发行。

(四)可转换公司债券的面值:每张面值 100 元人民币。

(五)募集资金总额:人民币 345,000.00 万元。

(六)发行方式:本次发行认购金额不足 345,000.00 万元的部分由联席主承销商包销。包销基数为 345,000.00 万元,联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 103,500.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

(七)配售比例

持有公司有限售条件股份的外资股东优先配售的环旭转债总计为 31,253 手,即 31,253,000 元,占本次发行总量的 0.91%;除持有公司有限售条件股份的外资股东外,公司其他原 A 股股东(含限售股股东)优先配售的环旭转债总计为 2,897,397 手,即 2,897,397,000 元,占本次发行总量的 83.98%;网上投资者最终缴款认购 508,639 手,占本次发行总量的 14.74%;网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,包销数量为 12,711 手,占本次发行总量的 0.37%。

(八)前十名可转换公司债券持有人及其持有量

序号	持有人名称	持有数量(张)	占总发行比例(%)
1	环诚科技有限公司	26,418,020.00	76.57
2	ASDI ASSISTANCE DIRECTION	312,530.00	0.91
3	日月光半导体(上海)有限公司	283,970.00	0.82
4	中国银行股份有限公司-华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	168,520.00	0.49
5	摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国 A 股基金	104,980.00	0.30
6	海通证券股份有限公司	95,330.00	0.28
7	中联润世(北京)投资有限公司	94,050.00	0.27
8	中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	59,040.00	0.17
9	国泰君安证券股份有限公司	31,780.00	0.09
10	高盛国际资产管理公司-高盛国际中国基金	24,900.00	0.07
合计		27,593,120.00	79.97

(九)发行费用

项目	金额(万元)
承销及保荐费用	1,927.36
会计师费用	30.00
律师费用	90.09
资信评级费	23.58
用于本次发行的信息披露及其他发行费用	198.86

注:上述费用均为不含税价。

二、本次承销情况

持有公司有限售条件股份的外资股东优先配售的环旭转债总计为 31,253 手,即 31,253,000 元,占本次发行总量的 0.91%;除持有公司有限售条件股份的外资股东外,公司其他原 A 股股东(含限售股股东)优先配售的环旭转债总计为 2,897,397 手,即 2,897,397,000 元,占本次发行总量的 83.98%;网上投资者最终缴款认购 508,639 手,占本次发行总量的 14.74%;网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,包销数量为 12,711 手,占本次发行总量的 0.37%。

三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费(含税金额)后的余额 3,429,570,000.00 元已由保荐机构(联席主承销商)于 2021 年 3 月 10 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验证,并出具了德师报(验)字(21)第 00113 号《验资报告》,本次发行可转债的募集资金总额 3,450,000,000.00 元减除承销及保荐费用以及会计师费用、律师费用、资信评级费,用于本次发行信息披露费用及其他发行费用合计 22,698,952.28 元(不含税)后,实际募集资金净额为 3,427,301,047.72 元。

四、参与上交所质押式回购交易的情况

公司未申请"环旭转债"参与债券质押式回购交易业务。

第六节 发行条款

一、本次发行基本情况

1、本次可转债发行于 2020 年 8 月 10 日经公司第五届董事会第三次会议审议通过,于 2020 年 9 月 9 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过,并于 2020 年 9 月 25 日经公司 2020 年度第二次临时股东大会审议通过。本次可转债的发行于 2021 年 1 月 21 日经中国证监会核准,核准文号为证监许可[2021]167 号。

2、证券类型:可转换公司债券。

3、发行规模:345,000 万元人民币。

4、发行数量:3,450.00 万张。

5、上市规模:345,000 万元人民币。

6、发行价格:按面值发行。

7、募集资金量及募集资金净额:本次可转债的募集资金为人民币 345,000 万元人民币(含发行费用),募集资金净额为 3,427,301,047.72 元。

8、募集资金用途:根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,结合公司实际经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况,本次发行可转债总额为 345,000 万元,扣除发行费用后,将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	盛夏厂芯片模组生产项目	91,000.00	86,000.00
2	越南厂可穿戴设备生产项目	140,000.00	56,000.00
3	惠州厂电子产品生产项目	135,000.00	100,000.00
4	补充流动资金项目	103,000.00	103,000.00
	合计	469,000.00	345,000.00

注:越南厂可穿戴设备生产项目总投资 20,000.00 万美元,按美元/人民币汇率 7.00 换算。

二、本次可转换公司债券发行条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模及发行数量

本次发行的可转债拟募集资金总额 345,000 万元,共计 3,450,000 手(34,500,000 张)。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币 100 元。

4、可转债基本情况

(1)债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年,即 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3 月 3 日。

(2)票面利率:第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.60%、第四年 1.30%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

(3)债券到期赎回:本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的 108.00%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

(4)还本付息的期限和方式:

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的本金和最后一年利息。

1)年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:年利息额;

B:本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

i:可转债的当年票面利率。

2)付息方式

a 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

b 付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

c 付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向可转债持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

d 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(5)初始转股价格:本次发行的可转债的初始转股价格为 20.25 元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(6)转股期限:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021 年 3 月 10 日,即募集资金划至发行人账户之日)起满 9 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止(即 2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日止)。

(7)债券评级情况:本次可转债主体环旭电子长期信用等级为 AA+,本次可转换公司债券信用等级为 AA+,评级展望稳定。

(8)资信评估机构:中诚信国际信用评级有限公司。

(9)担保事项:本次发行的可转换公司债券不提供担保。

5、发行时间

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2021 年 3 月 4 日(T 日)。

6、发行对象

(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即 2021 年 3 月 3 日,T-1 日)收市后登记在册的公司所有 A 股股东。

(2)向一般社会公众投资者网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。

7、发行方式

本次发行的环旭转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售,原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

(1)原 A 股股东可优先配售的可转债数量

①原 A 股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数,按原股东优先配售比例每股 0.001569 手计算可配售可转债手数,原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整。

截至 2021 年 3 月 3 日(T-1 日)环旭电子 A 股总股本 2,209,609,072 股,其中发行人回购专用账户持有的 11,332,177 股股份不享有原股东优先配售权,即享有原股东优先配售权的股本总数为 2,198,276,895 股。按本次发行优先配售比例计算,原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额为 3,450,000 手。

②除持有公司有限售条件股份的外资股东外,公司其他原 A 股股东(含限售股股东)的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为"环旭配债",配售代码为"764231"。原 A 股无限售条件股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整。

③持有公司有限售条件股份的外资股东的优先认购通过网下认购的方式,在保荐机构(联席主承销商)处进行。

原 A 股股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的网上申购。

(2)一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购,申购代码为"783231",申购简称为"环旭发债"。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手(10 张,1,000 元),超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1,000 手(1 万张,100 万元),如超过该申购上限,则整笔申购无效。

投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。

8、网上发行地点

全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。

9、锁定期

本次发行的环旭转债不设持有期限制,投资者获得配售的环旭转债上市首日即可交易。

10、承销方式

本次公开发行可转换公司债券由联席主承销商以余额包销的方式承销,本次发行认购金额不足 345,000 万元的部分由联席主承销商包销。包销基数为 345,000 万元,联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 103,500 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采